

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（<u>电话会议</u>）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2025 年 4 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、CTO 徐玉鹏先生，财务总监、副总经理金良凯先生，董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、请董秘对经营情况做个简要介绍？ 2024 年，得益于半导体行业去库存周期的结束、AI 应用场景的突破，公司在经营方面取得一定进展。营业收入同比增长超过 50%，营收增速在全球规模以上的封测企业中位居前列；2025 年第一季度，营收同比增长超过 30%，归母净利润实现扭亏为盈。 回顾 2024，公司二期的产能逐步释放；在深耕现有核心客户群的基础上，台系客户得到突破；此外，公司不断拓展新的应用领域，车规和运算的营收增长迅速。 展望后续，虽然半导体行业存在美国政策的一些扰动，但公司下游需求相对旺盛，预计仍能保持良好的增长态势。 2、请问关税对公司的影响程度？ 经过公司结合目前政策评估，关税对公司当前经营情况影响较小。根据客户的 forecast 情况，公司下游需求相对旺

	盛，二季度的景气度良好。 3、台湾地区客户及欧洲客户的增长情况？海外毛利率展望？ 2024 年两家台系客户已进入公司前五大客户行列，预计后续的订单增长仍超过公司整体水平，成为拉动公司营收增长的重要引擎；欧洲客户今年将加快本地部署。 2024 年境外客户营收占比 15~20%，境外毛利率与公司整体毛利率持平。目前境外营收以成熟产品为主，正在导入 AP 类 SoC 和车规等相对更复杂的产品，因此后续的产品价格和毛利率有进一步向上的趋势。 4、公司与台系客户的合作，以及未来的产品规划？ 公司与台系客户保持战略合作关系，出于对工艺成熟度的考量，目前量产的产品主要集中在 IoT 领域的成熟产品。现阶段正导入先进封装为主的新品，包括 FC 及汽车电子等。 5、今年的产能规划？ 公司今年的资本开支为 20-25 亿，相关设备的 move in 集中在今年下半年，因此本年度产能的扩张幅度相对平缓。 6、公司今年的投资和折旧增长情况？ 二期预计总投资额 110 亿，公司将根据客户需求和市场情况审慎稳健的控制投资节奏，预计公司 2025 年的折旧略有增加。 7、公司晶圆级封测的毛利率情况？满产的目标毛利率？ 公司晶圆级产品自 2023 年开始投产，随着产能持续爬坡，2024 年毛利率同比增加约 40 个百分点；2025 年晶圆级封测的营收依然保持增长态势，有望实现毛利率转正。 晶圆级产品满产后的毛利率将超过公司整体毛利率。 8、公司未来的研发投入规划？ 甬矽电子专注于中高端先进封装，围绕先进封装领域，
--	--

	公司研发投入持续提升，研发费用率大概维持在 6%左右。 9、公司产品下游结构？后续 IoT 领域的营收占比变化趋势？ 2024 年 AIoT 领域的营收增速最高，增长率同比超过 70%；PA 和安防相对平淡；汽车电子和运算类的产品营收增速最快，但占比仍较低。 目前，从公司下游的国内核心客户群和海外客户的需求看，来自 IoT 领域的需求比较旺盛；因此，IoT 领域的营收占比有进一步扩大的趋势。 10、车载 CIS 的需求情况以及今年的营收目标？ 公司 CIS 采取 BGA 的封装方案，需求较为旺盛，后续将根据客户需求决定扩产节奏。车规占公司营收比例较低，但增速较快。 11、2.5D 封装正式量产及实现收入大概需要多久？ 公司 2.5D 封装产线于 2024 年四季度通线，目前和相关客户做产品验证。但由于 2.5D 封装产品工艺复杂，验证周期较长，实现稳定量产需要一定时间。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 24 日